

| | |
|------|--------------------|
| タイトル | 電子基板の動作不良の原因を調べました |
|------|--------------------|

| | |
|----------------|--|
| 事例 | はんだ接合部の接合不良 |
| 試験内容と結果 | <p>いくつかLSIのパッケージが、基板に実装されており、そのうちの 하나가動作不良を起こしている。実装時にうまくはんだ付けが行われなかった可能性があるが、外部からはまったくはんだ接合部を観察することができない。そこで、X線CT装置を用いて、非破壊ではんだ接合部の断層画像を撮影した。その結果、数箇所、パッケージと基板とがうまく接合されていないことが判明した。実装時の基板のそりが原因であると推測されたので、パッケージの配置を検討することになった。</p> <p>(試験内容を分かりやすく説明するために、創作しています)</p> |
| 使用した装置 | <p>マイクロフォーカスX線CT装置 (東芝ITコントロールシステム(株)製、TOSCANER-32250 μhd)</p> |
| 手数料 (平成21年) | エックス線CT試験 9,960/1試料 |
| 担当部署 | 機械電子研究所 機械システム課 076-433-5466 |